



TG-PCM095 相变化材料

Phase Change Materials

REACH Compliant

RoHS Compliant

产品特性 Features

- 藉由材料热溶后的良好流动性
Good flow rate over phase change temperature
- 完整填充表面不平整缝隙
Fully filled the gaps of contact surface
- 低热阻抗
Low thermal impedance

产品应用端 Applications

电子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

保存方式 Storage

保存期限 12 个月及储存条件 25 度 C 以下。
Shelf Life: 12 months at or below 25°C

产品物性 Properties

导热系数 Thermal Conductivity : 9.5 W/m·K



Properties	Unit	TG-PCM095	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	9.5	ASTM D5470
厚度 Thickness	mm	0.20/0.25	ASTM D374
	inch	0.0079/0.0098	ASTM D374
颜色 Color	-	灰 Gray	-
软化温度 Phase Transition Temperature	°C	45	-
密度 Density	g/cm ³	2.55	ASTM D792
工作温度 Operating Temperature	°C	-50~+140	-
热阻抗 Thermal Impedance @10psi	°C *in ² /W	0.0173	ASTM D5470
热阻抗 Thermal Impedance @30psi	°C *in ² /W	0.0063	ASTM D5470
热阻抗 Thermal Impedance @50psi	°C *in ² /W	0.0057	ASTM D5470

※ 可依需求冲型裁切 Die-cut for different shapes

高柏科技股份有限公司 T-Global Techonology Co., Ltd.

T-PC003D-01

330058 桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com



注意：本技术数据表中的信息系高柏团队基于研究与测试所得出的最优数据。数据表所列参数仅为典型值，并不代表每一批次材料均进行测试。如有规格变更，恕不另行通知；对产品功能无影响的保护膜及离型纸，若无特殊要求，均以高柏默认标准为准。由于实际使用条件多种多样，超出我方控制范围，故本数据表中的建议不构成任何担保或法律责任。用户应根据实际应用需求，自行进行测试，以确认本产品在特定环境中的适用性。本产品销售不附带任何明示或暗示的适用性声明，不构成其适用于特定用途的保证。产品品质标准应以高柏与客户确认的发票、报价单或订单为准。我方不对用户基于本数据表延伸或修改内容而造成的结果承担任何责任，相关风险由用户自行承担。此外，本技术数据表所载信息不构成对现有用途、未来潜在专利冲突、工艺制造方法或产品使用建议的任何陈述或保证。